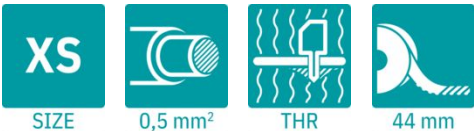


MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: negro, corriente nominal: 4 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MC 0,5/..-G-THT, paso: 2,5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON FK-MC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en: Downloads

Sus ventajas

- Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT

Datos comerciales

Código de artículo	1963667
Unidad de embalaje	330 Unidades
Cantidad mínima de pedido	330 Unidades
Clave de venta	AAATGA
Clave de producto	AAATGA
GTIN	4017918943110
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,94 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,49 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	DE

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	MC 0,5/...-G-THT
Línea de productos	COMBICON Connectors XS
Construcción	Componente adecuado para Through Hole Reflow
Número de polos	4
Paso	2,5 mm
Número de conexiones	4
Número de filas	1
Número de potenciales	4
Tipo de montaje	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	4 A
Tensión nominal U_N	160 V
Resistencia de contacto	2 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3)	32 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	1,5 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	2,5 kV
Tensión nominal (II/2)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	1,5 kV

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura THR/soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Indicaciones de procesamiento

Proceso	Soldadura por reflujo/ola
Moisture Sensitive Level	MSL 3
Classification Temperature T_c	245 °C
Ciclos soldad. por reflujo	3

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
-------------	--

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (3 µm - 5 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)	Níquel (1 µm - 3 µm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (3 µm - 5 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)	Níquel (1 µm - 3 µm Ni)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	IIIa
CTI según IEC 60112	250
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	2,5 mm
Anchura [w]	11,9 mm
Altura [h]	11,9 mm
Longitud [l]	10,1 mm
Altura total	8,1 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	3,8 mm
Dimensiones de patilla	0,8 x 0,8 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,4 mm
-------------------	--------

Ensayos mecánicos

Examen visual

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Examen dimensional

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-2:2003-01
---------------------------	--------------------------

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Resultado	Prueba aprobada
Resistencia de las rotulaciones	
Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Prueba aprobada
Polarización y codificación	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Portacontactos usado	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N	Prueba aprobada
Fuerzas al enchufar y desenchufar	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Número de ciclos	25
Fuerza al enchufar por polo aprox.	8 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox.	6 N

Ensayos eléctricos

Prueba térmica | Grupo de prueba C

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado	12

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	$10^{12} \Omega$

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	IIIa
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 250
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	32 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	1,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	0,8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	1,3 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	1,6 mm

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	160 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	1,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	0,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	1,6 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Prueba de durabilidad

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar	2,95 kV
Resistencia de contacto R_1	2 mΩ
Resistencia de contacto R_2	2,2 mΩ
Ciclos de enchufe	25

Ensayo climático

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión	0,2 dm ³ SO ₂ en 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico	100 °C/168 h
Tensión alterna soportable	1,39 kV

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)

Información sobre el embalaje

Esquema de dimensiones	
Tipo de embalaje	Correa de 44 mm de ancho
Ancho de cinta [W]	44 mm

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Medidas exteriores de la bobina [W2]	≤ 50,4 mm
Diámetro de la bobina [A]	≤ 330 mm
Tipo del embalaje exterior	Dry bag

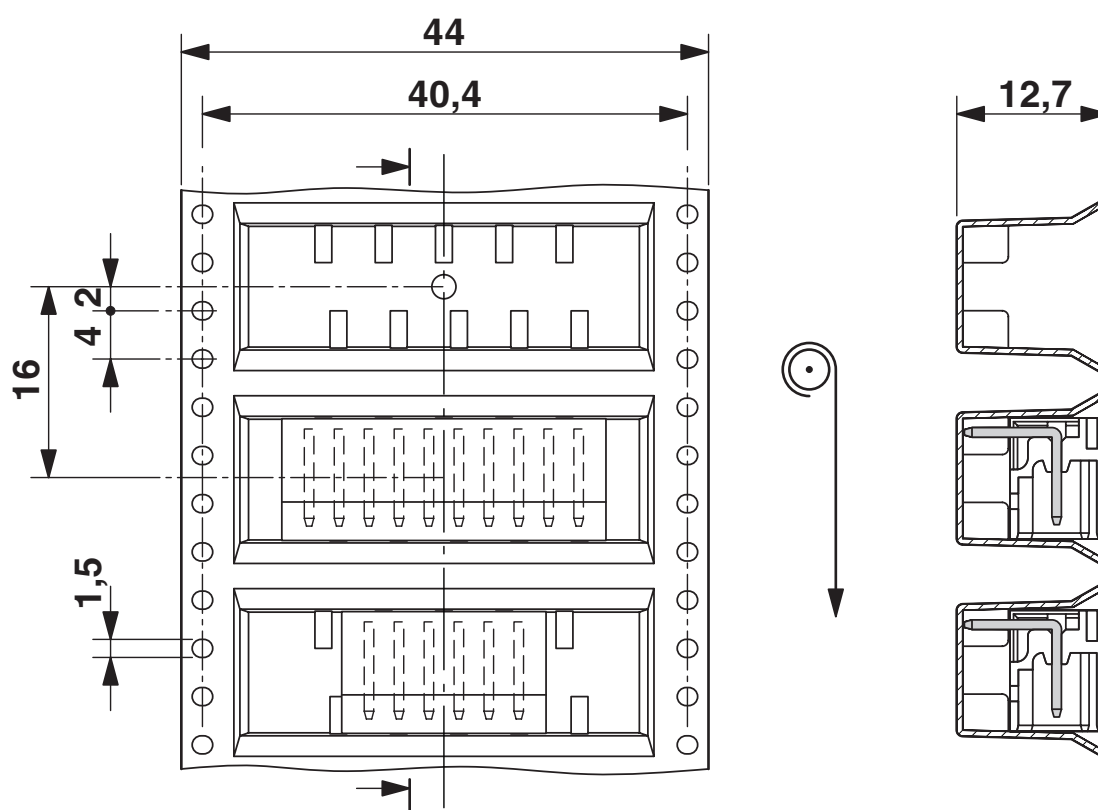
MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Dibujos

Esquema de dimensiones



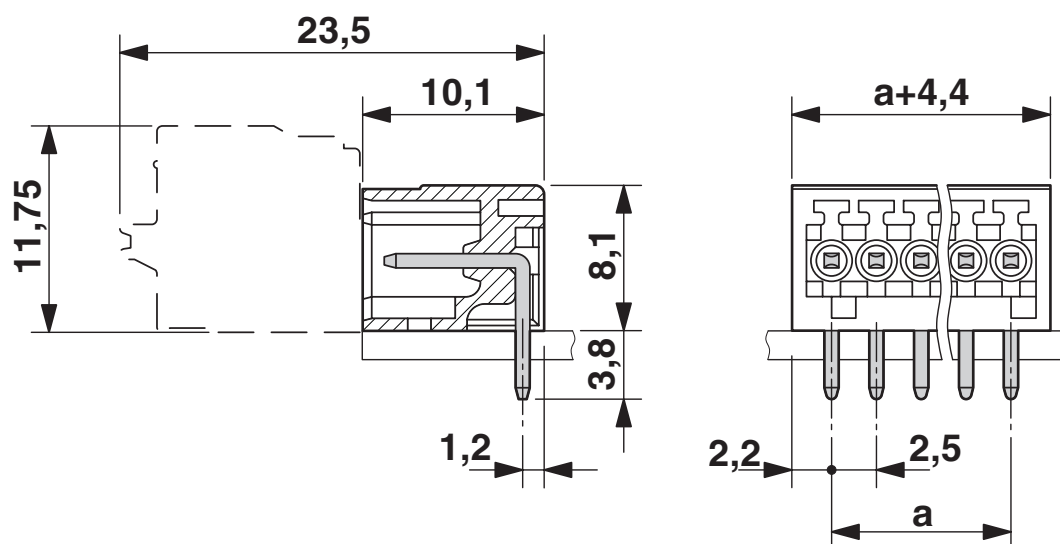
Dirección de la flecha = dirección de entrada

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Esquema de dimensiones

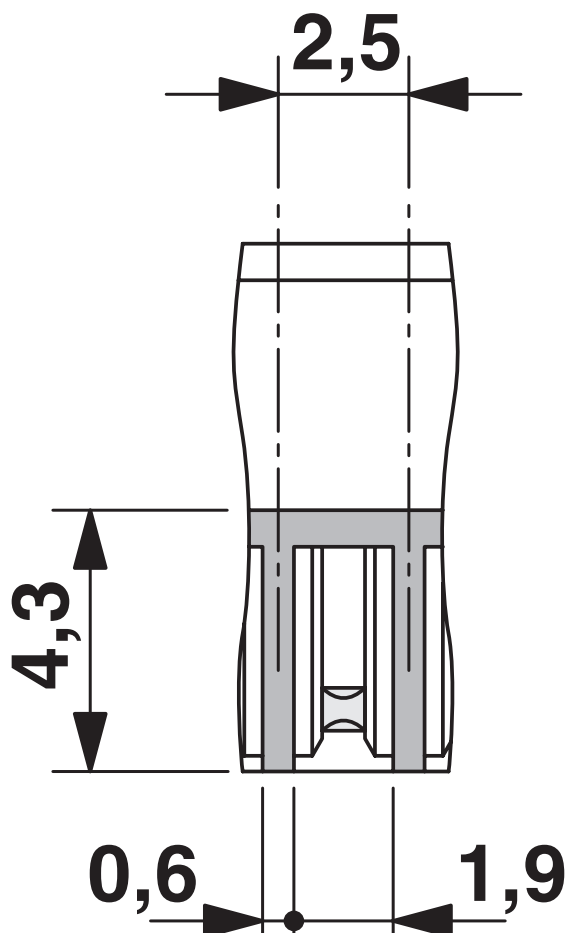


MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

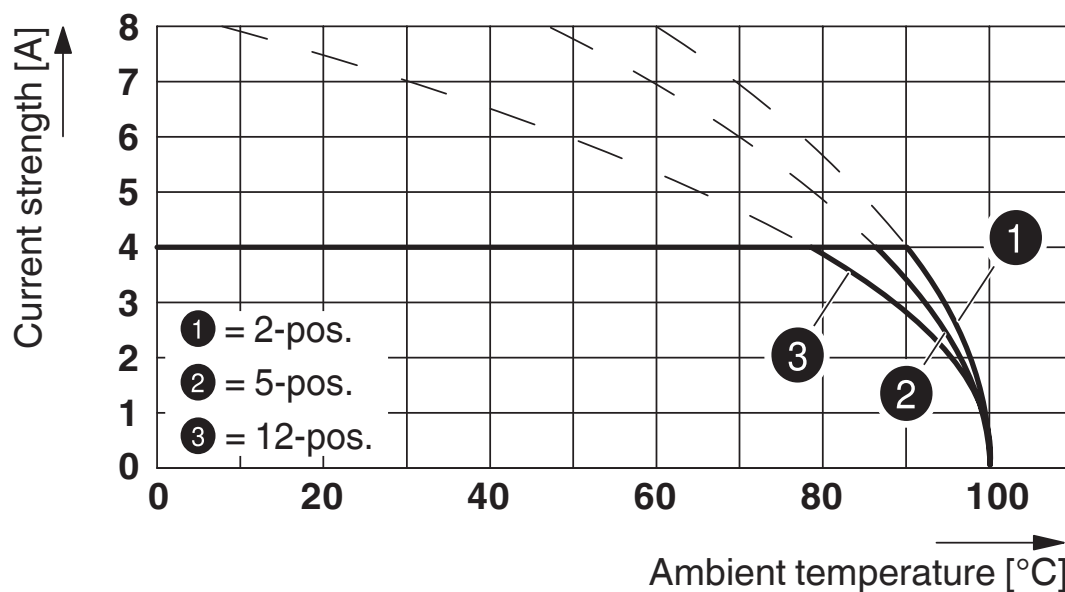
1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Esquema de dimensiones



Diagrama



Tipo: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 mit MC 0,5/...-G-2,5 THT

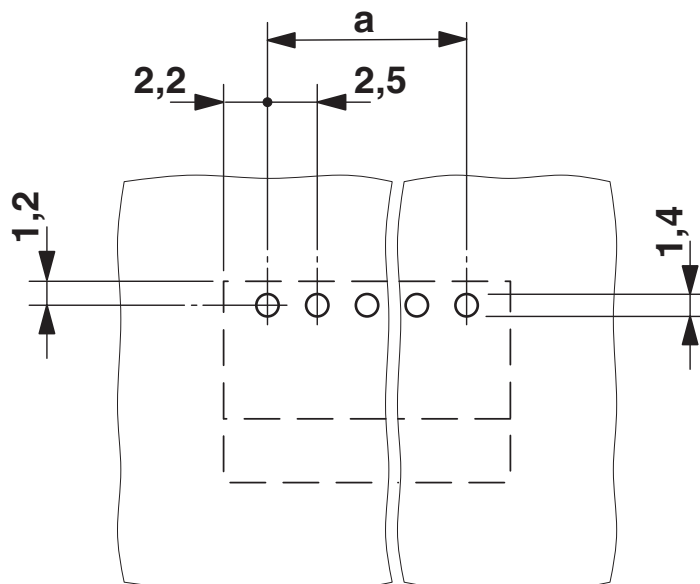
MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19990913				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	125 V	4 A	-	-

 Dictamen VDE con control de producción ID de homologación: 40013394				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	32 V	4 A	-	-

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1963667

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1963667>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es